中国集成电路封装行业发展分析及投资风险与战略研究报告(2024-2029版)

报告简介

集成电路封装在电子学金字塔中的位置既是金字塔的尖顶又是金字塔的基座。说它同时处在这两种位置都有很充分的根据。从电子元器件(如晶体管)的密度这个角度上来说，ic代表了电子学的尖端。但是ic又是一个起始点，是一种基本结构单元，是组成我们生活中大多数电子系统的基础。同样，ic不仅仅是单块芯片或者基本电子结构，ic的种类千差万别(模拟电路、数字电路、射频电路、传感器等)，因而对于封装的需求和要求也各不相同。

随着微电子机械系统器件和片上实验室器件的不断发展，封装起到了更多的作用：如限制芯片与外界的接触、满足压差的要求以及满足化学和大气环境的要求。人们还日益关注并积极投身于光电子封装的研究，以满足这一重要领域不断发展的要求。最近几年人们对ic封装的重要性和不断增加的功能的看法发生了很大的转变，ic封装已经成为了和ic本身一样重要的一个领域。这是因为在很多情况下，ic的性能受到ic封装的制约，因此，人们越来越注重发展ic封装技术以迎接新的挑战。

在封装测试业方面，我国半导体封装业从1956年研制出我国第一支晶体管开始，至今已发展成为占据我国半导体行业约半壁江山的大产业。目前，全球最大的封装厂商都已在中国大陆建有生产基地。中国境内较大的集成电路封装测试企业约为70家，其中本地或本地控股的有22家，其余48家均为独资、台资或外方控股企业，而近60%的企业集中在长三角地区。在封装技术方面，随着封装产品的多样化和高端封装产品的需求增加，封装企业在新技术的开发和生产上做出了更多的努力，取得了许多新的进展，逐步改变原来以中低档塑料封装为主的局面。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及集成电路封装行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国集成电路封装行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外集成电路封装行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了集成电路封装行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于集成电路封装产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国集成电路封装行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

报告目录

第一章 中国集成电路封装行业发展

第一节 集成电路封装行业概念及分类

一、集成电路封装行业概念

二、集成电路封装行业产品大类

三、集成电路封装行业特性分析

(1)行业周期性

(2)行业区域性

(3)行业季节性

四、集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析

第二节 集成电路封装行业政策环境分析

一、行业管理体制

二、行业相关政策

(1)《电子信息产业调整和振兴规划》

(2)发改委加大对集成电路行业的支持力度

(3)科技部重点支持集成电路重点专项

(4)《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

(5)海关支持软件产业和集成电路产业发展有关政策规定和措施

第三节 国内宏观经济环境分析

一、gdp历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、中国宏观经济发展预测分析

第四节 集成电路封装行业技术环境分析

一、集成电路封装技术演进分析

二、集成电路封装形式应用领域

三、集成电路封装工艺流程分析

四、集成电路封装行业新技术动态

第二章 2019-2023年中国集成电路产业发展分析

第一节 集成电路产业发展状况

一、集成电路产业链简介

二、集成电路产业发展现状分析

(1)行业发展势头良好

(2)行业技术水平快速提升

(3)行业竞争力仍有待加强

(4)产业结构进一步优化

三、集成电路产业区域发展格局分析

(1)三大区域集聚发展格局业已形成

(2)整体呈现“一轴一带”的分布特征

(3)产业整体将“有聚有分，东进西移”

四、集成电路产业面临的发展机遇

(1)产业政策环境进一步向好

(2)战略性新兴产业将加速发展

(3)资本市场将为企业融资提供更多机会

五、集成电路产业面临的主要问题

(1)规模小

(2)创新不足

(3)价值链整合不够

(4)产业链不完善

六、集成电路产业“十四五”发展预测

第二节 集成电路设计业发展状况

一、集成电路设计业发展概况

二、集成电路设计业发展特征

(1)产业规模持续扩大

(2)企业数量不断增长

(3)企业规模持续扩大

(4)技术能力大幅提升

三、集成电路设计业发展隐忧

四、集成电路设计业新发展策略

五、集成电路设计业“十四五”发展预测

第三章 2019-2023年中国集成电路制造行业数据监测分析

第一节 2019-2023年中国集成电路制造行业规模分析

一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

第二节 中国集成电路制造行业结构分析

一、企业数量结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

二、销售收入结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

第三节 2019-2023年中国集成电路制造行业产值分析

一、产成品增长分析

二、工业销售产值分析

三、出口交货值分析

第四节 2019-2023年中国集成电路制造行业成本费用分析

一、销售成本统计

二、费用统计

第五节 2019-2023年中国集成电路制造行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

第四章 2019-2023年中国集成电路封装行业发展分析

第一节 半导体行业发展分析

一、半导体行业指数对比分析

(1)费城半导体指数与道琼斯指数

(2)台湾电子零组件指数与台湾加权指数

(3)csrc电子行业指数与沪深300指数

二、全球半导体产销分析

(1)全球半导体产值情况

(2)全球半导体销售情况

三、全球半导体行业主要企业情况

(1)全球半导体10强

(2)全球领先半导体情况

四、中国半导体行业发展概况

五、半导体设备bb值分析

六、半导体行业景气预测

七、半导体行业发展趋势

(1)产业链分工是方向

(2)综合厂商向轻资产转型

(3)封装环节产值逐年成长

(4)封装环节外包也是趋势

第二节 集成电路封装行业发展分析

一、集成电路封装行业规模分析

二、集成电路封装行业发展现状分析

三、集成电路封装行业利润水平分析

四、大陆厂商与业内领先厂商的技术比较

五、集成电路封装行业影响因素分析

六、集成电路封装行业发展趋势及前景预测

第三节 集成电路封装类专利分析

一、专利分析样本构成

(1)数据库选择

(2)检索方式

二、封装类专利分析

(1)专利公开年度趋势

(2)国内外专利公开趋势对比

(3)国内专利公开主要省市分布

(4)ipc技术分类趋势分布

(5)主要权利人分布情况

第四节 集成电路封装过程部分技术问题探讨

一、集成电路封装开裂产生原因分析及对策

(1)封装开裂的影响因素分析

(2)管控影响开裂的因素的方法分析

二、集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策

(1)产生芯片弹坑问题的因素分析

(2)预防芯片弹坑问题产生的方法

第五章 2019-2023年中国集成电路封装行业市场需求分析

第一节 集成电路市场分析

一、集成电路市场规模

二、集成电路市场结构分析

(1)集成电路市场产品结构分析

(2)集成电路市场应用结构分析

三、集成电路市场竞争格局

四、集成电路国内市场自给率

五、集成电路市场发展预测

第二节 集成电路封装行业需求分析

一、计算机领域对行业的需求分析

(1)计算机市场发展现状

(2)集成电路在计算机领域的应用

(3)计算机领域对行业需求的拉动

二、消费电子领域对行业的需求分析

(1)消费电子市场发展现状

(2)集成电路在消费电子领域的应用

(3)消费电子领域对行业需求的拉动

三、通信设备领域对行业的需求分析

(1)通信设备市场发展现状

(2)集成电路在通信设备领域的应用

(3)通信设备领域对行业需求的拉动

四、工控设备领域对行业的需求分析

(1)工控设备市场发展现状

(2)集成电路在工控设备领域的应用

(3)工控设备领域对行业需求的拉动

五、汽车电子领域对行业的需求分析

(1)汽车电子市场发展现状

(2)集成电路在汽车电子领域的应用

(3)汽车电子领域对行业需求的拉动

六、其他应用领域对行业的需求分析

第六章 2019-2023年中国集成电路封装行业市场竞争分析

第一节 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

一、现有竞争者之间的竞争

二、关键要素的供应商议价能力分析

三、消费者议价能力分析

四、行业潜在进入者分析

五、替代品风险分析

第二节 集成电路封装行业国际竞争格局分析

一、国际集成电路封装市场总体发展状况

二、国际集成电路封装市场竞争状况分析

三、国际集成电路封装市场发展趋势分析

(1)封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本

(2)主板材料的变化趋势

第三节 集成电路封装行业国内竞争格局分析

一、国内集成电路封装行业竞争格局分析

二、国内集成电路封装行业集中度分析

(1)行业销售收入集中度分析

(2)行业利润集中度分析

(3)行业工业总产值集中度分析

三、国内集成电路封装行业国际竞争力分析

第七章 2019-2023年跨国企业在华市场竞争力分析

第一节 台湾日月光集团竞争力分析

一、企业发展简介

二、企业经营情况分析

三、企业主营产品及应用领域

四、企业市场区域及行业地位分析

五、企业在中国市场投资布局情况

第二节 美国安靠(amkor)公司竞争力分析

一、企业发展简介

二、企业经营情况分析

三、企业主营产品及应用领域

四、企业市场区域及行业地位分析

五、企业在中国市场投资布局情况

第三节 台湾矽品公司竞争力分析

一、企业发展简介

二、企业经营情况分析

三、企业主营产品及应用领域

四、企业市场区域及行业地位分析

五、企业在中国市场投资布局情况

第四节 新加坡stats-chippac公司竞争力分析

一、企业发展简介

二、企业经营情况分析

三、企业主营产品及应用领域

四、企业市场区域及行业地位分析

五、企业在中国市场投资布局情况

第五节 力成科技股份有限公司竞争力分析

一、企业发展简介

二、企业经营情况分析

三、企业主营产品及应用领域

四、企业市场区域及行业地位分析

五、企业在中国市场投资布局情况

第六节 飞思卡尔公司竞争力分析

一、企业发展简介

二、企业经营情况分析

三、企业主营产品及应用领域

四、企业市场区域及行业地位分析

五、企业在中国市场投资布局情况

第七节 英飞凌科技公司竞争力分析

一、企业发展简介

二、企业经营情况分析

三、企业主营产品及应用领域

四、企业市场区域及行业地位分析

五、企业在中国市场投资布局情况

第八章 2019-2023年中国集成电路封装行业产品市场分析

第一节 集成电路封装行业bga产品市场分析

一、bga封装技术水平

二、bga产品主要应用领域

三、bga产品需求拉动因素

四、bga产品市场规模分析

五、bga产品市场前景展望

第二节 集成电路封装行业sip产品市场分析

一、sip封装技术水平

二、sip产品主要应用领域

三、sip产品需求拉动因素

四、sip产品市场规模分析

五、sip产品市场前景展望

第三节 集成电路封装行业sop产品市场分析

一、sop封装技术水平

二、sop产品主要应用领域

三、sop产品市场发展现状

四、sop产品市场前景展望

第四节 集成电路封装行业qfp产品市场分析

一、qfp封装技术水平

二、qfp产品主要应用领域

三、qfp产品市场发展现状

四、qfp产品市场前景展望

第五节 集成电路封装行业qfn产品市场分析

一、qfn封装技术水平

二、qfn产品主要应用领域

三、qfn产品市场发展现状

四、qfn产品市场前景展望

第六节 集成电路封装行业mcm产品市场分析

一、mcm封装技术水平概况

(1)概念简介

(2)mcm封装分类

二、mcm产品主要应用领域

三、mcm产品需求拉动因素

四、mcm产品市场发展现状

五、mcm产品市场前景展望

第七节 集成电路封装行业csp产品市场分析

一、csp封装技术水平概况

(1)概念简介

(2)csp产品特点

(3)csp封装分类

(4)csp封装工艺流程

二、csp产品主要应用领域

三、csp产品市场发展现状

四、csp产品市场前景展望

第八节 集成电路封装行业其他产品市场分析

一、晶圆级封装市场分析

(1)概念简介

(2)产品特点

(3)主要应用领域

(4)市场规模与主要供应商

(5)前景展望

二、覆晶/倒封装市场分析

(1)概念简介

(2)产品特点

(3)市场前景

三、3d封装市场分析

(1)概念简介

(2)封装方法

(3)发展现状与前景

第九章 2019-2023年中国集成电路封装行业主要企业经营分析

第一节 集成电路封装企业发展总体状况分析

一、集成电路封装行业制造商工业总产值排名

二、集成电路封装行业制造商销售收入排名

三、集成电路封装行业制造商利润总额排名

第二节 集成电路封装行业领先企业个案分析

一、长电科技

二、深圳赛意法微电子有限公司

三、南通富士通微电子股份有限公司

四、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司

五、英特尔产品(成都)有限公司

六、无锡菱光科技有限公司

七、恒宝股份有限公司

八、南京汉德森科技股份有限公司

九、深圳市比亚迪微电子有限公司

十、常州市欧密格电子科技有限公司

第十章 2024-2029年中国集成电路封装行业投资分析及建议

第一节 集成电路封装行业投资特性分析

一、集成电路封装行业投资壁垒

(1)技术壁垒

(2)资金壁垒

(3)人才壁垒

(4)严格的客户认证制度

二、集成电路封装行业盈利模式

三、集成电路封装行业盈利因素

第二节 集成电路封装行业投资兼并与重组分析

一、集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

二、国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

三、国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

(1)通富微电公司投资兼并与重组分析

(2)华天科技公司投资兼并与重组分析

(3)长电科技公司投资兼并与重组分析

四、集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

第三节 集成电路封装行业投融资分析

一、电子发展基金对集成电路产业的扶持分析

(1)电子发展基金对集成电路产业的扶持情况

(2)电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

二、集成电路封装行业融资成本分析

三、半导体行业资本支出分析

第四节 集成电路封装行业投资建议

一、集成电路封装行业投资机会分析

二、集成电路封装行业投资风险分析

三、集成电路封装行业投资建议

(1)投资区域建议

(2)投资产品建议

(3)技术升级建议

图表目录

图表：2019-2023年国内生产总值

图表：2019-2023年居民消费价格涨跌幅度

图表：2019-2023年居民消费价格比上年涨跌幅度(%)

图表：2019-2023年年末国家外汇储备

图表：2019-2023年财政收入

图表：2019-2023年全社会固定资产投资

图表：2019-2023年分行业城镇固定资产投资及其增长速度(亿元)

图表：2019-2023年固定资产投资新增主要生产能力

图表：2019-2023年房地产开发和销售主要指标完成情况

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业企业数量增长趋势图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业从业人数增长趋势图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业资产规模增长趋势图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业不同类型企业数量分布图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业不同所有制企业数量分布图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业不同类型企业销售收入分布图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业不同所有制企业销售收入分布图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业产成品增长趋势图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业工业销售产值增长趋势图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业出口交货值增长趋势图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业销售成本增长趋势图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业费用使用统计图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业主要盈利指标统计图

图表：2019-2023年我国集成电路制造行业主要盈利指标增长趋势图

图表：封装技术的演进

图表：各种集成电路封装形式应用领域

图表：集成电路封装工艺流程

图表：集成电路产业链示意图

图表：pbga(塑料焊球阵列)封装

图表：cmmb系统总体构成

图表：cmmb应用市场结构(单位：%)

图表：cmmb芯片产业链示意图

图表：带有倒装、打线等多种技术的3d sip封装示意图

图表：sop封装产品

图表：qfn生产工艺流程图

图表：qfn产品厚度的演变

图表：几种类型csp结构组成图

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费)　Emai：kf@51baogao.cn

本文地址：https://www.51baogao.cn/baogao/20201123/190078.shtml

在线订购：点击这里